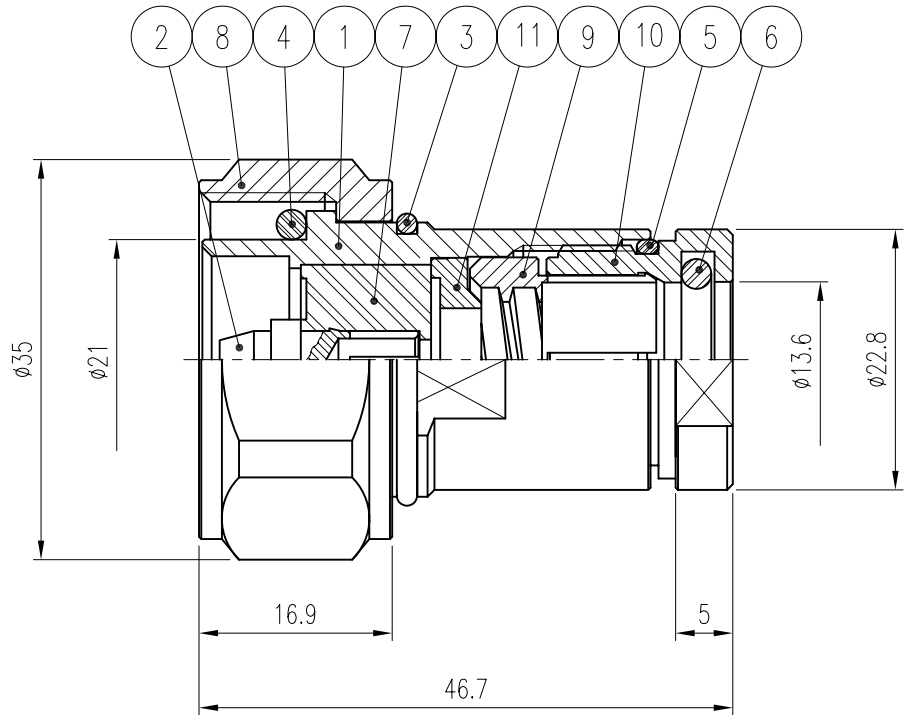


1										수 정 내 용				
ST	가공									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	도면 양식 변경	이상윤	최영호	2003. 1. 8.
ST(개선)														



11	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00011-135/1 (P5007)
10	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00014-135/1 (M5006)
9	COVER	1	MBsBD	Silver Plate	DSR00062-15/1 (R5003)
8	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00078-15/2 (K5015)
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01049-N/1 (H5043)
6	GASKET	1	SILICON		DGK00041-7/1 (H5009)
5	GASKET	1	SILICON		DGK00048-N/1 (G5008)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00054-N/1 (G5006)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00123-N/1 (G5005)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01120-5/2(E5043)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01473-5/2 (D5051)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일 2002. 5. 27.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	재도	도명			1/2" SF DIN-P	
	작성부서	연 구 소			A4	도번 CN00569-7/2
	작도	NS	단위 mm	중량		K318-089-000